



SUOMI-FINLAND

(FI)

Patentti- ja rekisterihallitus
Patent- och registerstyrelsen

(71) Hakija - Sökande

1. Alpha Fry Limited, Tandem House, Marlowe Way, Beddington Farm Road Croydon, CRO 4XS, United Kingdom, (GB)

(72) Keksijä - Uppfinnare

1. McGrath, Peter Thomas, 16782 Von Karman avenue,, Irvine, CA 92714, USA, (US)
2. Price, Andrew David, 36 St. James avenue, Sutton, Surrey SM1 2TH, United Kingdom, (GB)

(74) Asiamies - Ombud: Berggren Oy Ab, Jaakonkatu 3 A, 00100 Helsinki

(54) Keksinnön nimitys - Uppfinningens benämning

Kuparipinnoite
Kopparbeläggning

(57) Tiivistelmä - Sammandrag

Metallipinta, tavallisesti kupari mikrokarhennetaan polymerimateriaalien tarttuvuuden parantamiseksi käyttämällä tarttumista edistävää koostumusta, joka sisältää vetyperoksidia, epäorgaanista happoa, korroosionestoainetta, joka on esimerkiksi triatsolia, tetratsolia tai imidatsolia, ja kvaternääristä ammoniumyhdistettä olevaa pinta-aktiivista ainetta. Menetelmä on erityisen arvokas monikerros-PCB-levyjen valmistuksessa kerrosten välisen tartunnan edistämiseksi.

En metallyta, vanligen koppar mikrosträvas för att förbättra häftförmåga av polymera material, genom att använda en häftbefrämjande komposition, som innehåller väteperoxid, en oorganisk syra, en korrosioninhibitor, som är till exempel en triazol, tetrazol eller imidazol, och ett ytaktivt ämne, som består av en kvaternärisk ammoniumförening. Processen är särskilt värdefull vid produktion av multiskikt-PCB-kort för att befrämja häftförmåga mellan skikten.

(11) (21) Patenttihakemus - Patentansökan 972472

(51) Kv.lk.6 - Int.kl.6

H 05K 3/38

(22) Hakemispäivä - Ansökningsdag 11.06.1997

(24) Alkupäivä - Löpdag 12.12.1995

(41) Tullut julkiseksi - Blivit offentlig 11.08.1997

(86) Kv. hakemus - Int. ansökan PCT/GB95/02909

(32) (33) (31) Etuoikeus - Prioritet

12.12.1994 GB 9425090 P

